



		paste活性不足。s70g可以根本地解決以往grn360系列的問題。		
底面電極void		對於底面電極零件容易發生void問題，s70g和grn360系列相比約多了1/2的抑制效果。		
flux飛散		對於flux飛散造成連接端等接續異常，s70g和grn360系列相比成功地削減50~80%。		
潤濕性不良		使用大氣迴焊造成的氧化、flux活性的損失為主要潤濕性惡化的原因，容易造成大面積land的問題。s70g比起grn360系列帶來更良好的焊接潤濕性。		
使用壽命（版上的酸化）		s70g和grn360系列除了同樣可保證長時間印刷之外，其印刷作業中焊材粉末的氧化抑制、更加穩定、且減少廢棄損失。		
印刷停止後轉寫率低下		停止作業後，再啟動時印刷量安定性沒問題。s70g在停止前後可確保安定的轉寫性。		
實裝後的電路檢查		s70g殘留在焊材上的flux極少，可快速正確地進行電路檢查。		

頂層焊材粉末 solder paste s70g	試驗方法	合金組成	ag3.0-cu0.5-sn殘 ( m705 )	-
	熔融溫度	固相線溫度	217 pitch溫度 ( 液相線 )	dsc示差熱分析儀
			219	
	粉末形狀	球形		sem電子顯微鏡
	焊材粉末粒徑	type3 : 25?45 μ m	type4 : 25?36 μ m	sem及雷射法
flux	flux type	flux 活性度	rol0	j-std-004j-std-004
	鹵素	溴 ( br ) 系0.02%以下 ( 本產品不是無鹵素錫膏 )		電位差滴定 ( flux單獨測

	表面絕緣抵抗試驗 ( 40c90%rh,168hr )	over 1.0e+12	定) jis z 3284
	遷移試驗 ( 85c85%rh bias dc45v, 1000hr )	over 1.0e+9未發生遷移	jis z 3284
	銅鏡試驗	pass	jis z 3197
	氟化物試驗	pass	jis z 3197
ソルダペースト	黏度	190pa.s	jis z 3284
	搖變性指數	0.65	jis z 3284
	flux含有量	11.5%	jis z 3197
	熱坍塌特性	0.3mm以下	jis z 3284
	黏著性/保持時間 ( 1.0n以上 )	1.3n/24h以上	jis z 3284
	銅板腐蝕試驗	合格	jis z 3197
	保存期限 ( 冷藏:0 ~ 10c未開封 )	6個月	-

適用型號連接引腳等零件	type3 700.65?0.45mm pitch	0.5?0.4mm pitch	0.3mmpitch
bga, lga等底面電極零件	> 0.65mm pitch	0.65?0.5mm pitch	0.4?0.3mm pitch
chip零件size ( mm表示 )	> 1608?1005	1005?0603	0402

實裝密度/ pitch、零件尺寸

使用粉末sem 照片

type 3 粉末 ( 25?45 μ m )

type 4 粉末 ( 25?36 μ m )

type 5 粉末 ( 15?25 μ m )

您對任何品質問題、生產率提升對策等有疑問的地方，請務必提出討論。  
使用合金為m705 ( sn-3.0ag-0.5cu ) 為主的snagcu系合金，也歡迎詢問其他相關合金組成。